

大塚電子Webセミナー

近年先端半導体は、微細化の限界が近づく中、新たな後工程技術の実用化が注目を浴びています。シリーズにわたってお届けする第2回の半導体膜厚セミナーは、注目の後工程技術を交えた講演になります。

特別講演

半導体の中間工程・後工程における膜厚測定

15:00 ~ 16:00

国立研究開発法人 産業技術総合研究所

デバイス技術研究部門 3D 集積システムグループ
総括研究主幹 高橋 健司 様

半導体製造の中間工程ではTSVやハイブリッドボンディングなどの従来にない配線の構造が実用化されており、後工程ではチップの薄厚化が進んでSi厚の管理が必要になっています。本セミナーではこれらの工程の概要と膜厚測定の重要性について解説します。

大塚電子の膜厚測定装置のご紹介

16:00 ~ 16:10

大塚電子株式会社

新家 俊輝

質疑応答

16:10 ~ 16:30

開催日

2021年9月30日(木)

時間

15:00~16:30

お申込み方法

本セミナーは無料で参加できます。

下記のHPより必要事項をご入力の上、お申し込みください。

<https://www.otsukael.jp/event/detail/eventid/381>

ご視聴方法：本セミナーは Microsoft Teams を使用します。

パソコンまたはタブレットの場合はアプリをダウンロードする必要なしにブラウザで参加できます

※推奨ブラウザ：Microsoft Edge または Google Chrome

※スマホで参加の場合はアプリをダウンロードする必要があります

大塚電子株式会社

お問い合わせ

担当：西井・岡本

■本社・営業部 TEL. (072) 855-8550
〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目26-3

■東京支店 TEL. (042) 644-4951
〒192-0082 東京都八王子市東町1-6 橋完LKビル4F

□E-Mail webseminar@otsukaele.jp